

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASMPPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 截至二零二三年九月三十日止三個月之 二零二三年第三季度未經審核業績公布

#### 先進封裝 在疲弱行業中表現亮麗

#### 集團財務概要：二零二三年第三季度

- \* 銷售收入為港幣 34.7 億元(4.44 億美元)，按年-23.8%，按季亦-10.9%
- \* 新增訂單總額為港幣 29.6 億元(3.79 億美元)，按年-18.3%，按季亦-1.8%
- \* 毛利率為 34.2%，按年-670 點子，按季亦-594 點子
- \* 經營利潤率為 1.9%，按年-1,254 點子，按季亦-802 點子
- \* 盈利為港幣 1,280 萬元，按年-97.9%，按季亦-95.9%
- \* 每股基本盈利為港幣 0.04 元，按年-97.3%，按季亦-94.7%

#### 非香港財務報告準則計量<sup>1</sup>：

- \* 經調整盈利為港幣 4,540 萬元，按年-92.6%，按季亦-85.3%
- \* 經調整每股基本盈利為港幣 0.11 元，按年-92.7%，按季亦-85.3%

#### 二零二三年第四季度銷售收入預測

- \* 將介乎 3.9 億美元至 4.6 億美元之間，以其中位數計按年-23.2%，按季亦-4.2%

<sup>1</sup> 有關非香港財務報告準則計量之詳情，請參閱載於本公告第十頁的「香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬」。

ASMPT Limited 董事會欣然宣布截至二零二三年九月三十日止三個月之未經審核業績如下：

## 業績摘要

ASMPT Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASMPT」）於截至二零二三年九月三十日止三個月（「二零二三年第三季度」）錄得銷售收入為港幣 34.7 億元（4.44 億美元），較二零二二年第三季度按年減少 23.8%。集團二零二三年第三季度的綜合除稅後盈利為港幣 1,280 萬元（根據非香港財務報告準則計量<sup>1</sup>經調整為港幣 4,540 萬元），較去年同期的盈利港幣 6.17 億元減少 97.9%。二零二三年第三季度的每股基本盈利為港幣 0.04 元（根據非香港財務報告準則計量<sup>1</sup>經調整為港幣 0.11 元），而二零二二年第三季度則為港幣 1.50 元。

## 管理層討論及分析

二零二三年第三季度的業務回顧將由集團最突出的業務亮點開始解說，接著是集團及其分部，即半導體解決方案分部（「SEMI」）及 SMT 解決方案分部（「SMT」）的財務回顧。

### 二零二三年第三季度集團業務亮點

集團第三季度的業務繼續受持續疲弱的行業狀況影響，在審慎的消費者情緒下，供求狀態仍未轉好。

集團獨特及廣泛的產品組合在一定程度上緩解了對業務的壓力，即使 SMT 解決方案分部銷售收入趨於常態化，仍連續五個季度高於 SEMI。SEMI 雖現零星需求，惟全面復甦仍未可見。

就終端市場應用而言，汽車和工業的銷售收入貢獻持續佔集團銷售收入的最高比例。

### 先進封裝（「AP」）長期增長具備堅實基礎

集團的先進封裝解決方案需求持續增長，這很大程度上是受全球對生成式人工智能及高性能計算（「HPC」）應用日益增長的需求所推動。這使集團多項綜合先進封裝解決方案受惠，並令集團對其先進封裝解決方案套件的長期潛力充滿信心。亮點如下：

**熱壓焊接（「TCB」）：**熱壓焊接於本季度繼續為集團貢獻最多的先進封裝新增訂單總額及銷售收入。

邏輯封裝需求繼續推動熱壓焊接增長勢頭。集團用於生成式人工智能應用的熱壓焊接解決方案的訂單來自領先的晶圓代工及 OSAT 客戶，而高性能計算應用的訂單則來自領先的邏輯垂直整合製造客戶。集團正與主要的生成式人工智能企業緊密合作，並預期邏輯應用的訂單將持續強勁。

至於高頻寬記憶體（「HBM」）市場，集團繼續與多家記憶體企業合作，以滿足客戶對新一代高頻寬記憶體更嚴格的封裝需求。

**覆晶回流焊接（「MR」）高精確固晶：**儘管熱壓焊接在生成式人工智能應用方面增長勢頭強勁，集團仍繼續接獲覆晶回流焊接設備的訂單，並深化與領先晶圓代工、記憶體及 OSAT 客戶的業務合作。

## 管理層討論及分析(續)

**混合式焊接 (「HB」)：** 繼第一季度接獲首個混合式焊接訂單後，集團從另一位客戶獲得了第二個混合式焊接訂單。該混合式焊接設備將用於 3D 集成，並預計將於二零二四年下半年交付。

**SMT 配置：** 人工智能驅動伺服器客戶對集團 SMT 配置設備的需求仍然強勁。集團的先進配置設備亦接獲來自領先晶圓代工客戶的訂單。

**光子：** 集團的光子及矽光子解決方案能夠滿足生成式人工智能應用對極高頻寬傳輸的要求，並接獲領先人工智能客戶的重複訂單，以用於其收發器擴充計劃。集團預計此訂單勢頭將持續下去。

### 集團二零二三年第三季度財務回顧

(港幣百萬元)	二零二三年 第三季度	按季	按年
新增訂單總額	2,961.3 (3.79 億美元)	-1.8%	-18.3%
銷售收入	3,474.4 (4.44 億美元)	-10.9%	-23.8%
毛利率	34.2%	-594 點子	-670 點子
經營利潤率	1.9%	-802 點子	-1,254 點子
經調整盈利	45.4	-85.3%	-92.6%
經調整盈利率	1.3%	-659 點子	-1,221 點子

行業整體疲弱，令半導體解決方案分部及 SMT 解決方案分部的銷售收入皆減少，故集團於二零二三年第三季度的銷售收入按季及按年均錄得下跌。

就新增訂單而言，一間領先的高密度基板製造商由於現有產能的消化速度慢於其預期，於二零二三年第三季度取消了其面板沉積設備的個別訂單。若撇除此項取消，集團於二零二三年第三季度的新增訂單總額按季上升約 6%。新增訂單總額按年減少，則主要由於行業較為疲弱所致。集團於二零二三年九月三十日，未完成訂單總額為 9.22 億美元。

集團的毛利率下降主要由於不利的產品組合、銷量影響及就存庫期較長的存貨作出撥備所致。毛利率下降主要源自半導體解決方案分部。

為應對充滿挑戰的宏觀經濟環境及持續疲弱行業狀況，集團持續推行成本控制及提高效率的措施，其中包括於二零二三年第三季度進行有定向性的人員裁減，佔集團整體勞動力低單位數百分比。

集團的經營利潤率和盈利率按季及按年均錄得下跌，主要是由於銷量和毛利率下降所致。

於二零二三年九月三十日，集團的現金流狀況穩健，現金及銀行存款總額達港幣 41.7 億元，銀行借款亦保持穩定，為港幣 20 億元。

## 管理層討論及分析(續)

### 二零二三年第三季度半導體解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二三年 第三季度	按季	按年
新增訂單總額	1,325.7 (1.69 億美元)	+4.4%	-10.9%
銷售收入	1,574.6 (2.01 億美元)	-4.9%	-28.7%
毛利率	31.9%	-1,076 點子	-1,268 點子
分部盈利/(虧損)	(110.6)	NM	NM
分部盈利率	-7.0%	-868 點子	-2,048 點子

NM: 無意義

半導體解決方案分部的銷售收入佔集團二零二三年第三季度總銷售收入約 45%。該分部的銷售收入按季錄得溫和下降，主要受業務單位（「BU」）的以下發展所影響：

- (i) 集成電路／離散器件業務單位按季錄得穩定的銷售收入，當中熱壓焊接的佔比最大，其次是用於汽車解決方案的塑封和燒結。
- (ii) 光電業務單位的銷售收入按季錄得增長。用於傳統顯示器的引線焊接機銷售收入亦有所增加。
- (iii) 由於全球智能手機市場持續疲弱，CIS 業務單位的銷售收入受到不利的影響。

新增訂單總額主要來自先進封裝及汽車終端市場應用。撇除上述面板沉積設備的訂單取消，半導體解決方案分部的新增訂單總額按季增長約 22%。

由於不利的產品組合及就存庫期較長的存貨作出撥備，分部毛利率按季錄得下跌。影響產品組合的綜合因素包括：因產品升級計劃而逐步替代利潤較低的舊款產品和光電焊線銷售收入相對較高、以及與高端智能手機相關的產品銷售下降。

### 二零二三年第三季度 SMT 解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二三年 第三季度	按季	按年
新增訂單總額	1,635.6 (2.09 億美元)	-6.4%	-23.5%
銷售收入	1,899.8 (2.43 億美元)	-15.4%	-19.3%
毛利率	36.0%	-218 點子	-134 點子
分部盈利	258.0	-39.7%	-44.0%
分部盈利率	13.6%	-548 點子	-600 點子

SMT 解決方案分部的銷售收入佔集團二零二三年第三季度總銷售收入約 55%。分部銷售收入按季下降，主要由於高端配置及印刷設備的銷售收入下降，但降幅部分被 SMT 解決方案分部先進封裝設備的增長所抵銷。汽車及工業應用合計貢獻近一半的 SMT 解決方案分部銷售收入。

## 管理層討論及分析(續)

隨著 SMT 解決方案分部的潛在市場常態化，其新增訂單總額按季下降。儘管工業和汽車終端市場繼續佔分部新增訂單總額最大比例，但是人工智能相關伺服器應用的需求亦有所提升。

分部毛利率按季下降，主要由於銷量效應所致。

### 前景

短期內，疲弱的經濟及電子產品終端市場需求，將繼續延長行業庫存調整期，並限制集團客戶群的資本支出。

綜合上述因素及季節性影響，集團預期二零二三年第四季度的銷售收入將介於 3.9 億美元至 4.6 億美元之間，以其中位數計按年及按季分別減少 23.2%和 4.2%。

長遠而言，憑藉其獨特兼廣泛的產品組合，集團對其前景及增長潛力依然保持樂觀。而汽車電動化、智能工廠、綠色基礎設施、5G、物聯網及生成式人工智能增長推動的高性能計算的長期結構性趨勢亦加強了集團的信心。為支持日益數碼化互聯的世界，越來越多的組織在為日益多樣化的全球供應鏈做好準備。集團相信上述趨勢將促使資本性支出的增長。

# 財務概要

## 簡明綜合損益表

	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	
銷售收入	2	3,474,436	3,900,866	4,561,956
銷貨成本		(2,287,756)	(2,336,741)	(2,698,103)
毛利		1,186,680	1,564,125	1,863,853
其他收入		68,826	28,285	59,977
銷售及分銷費用		(387,707)	(405,385)	(449,247)
一般及行政費用		(238,574)	(257,845)	(257,279)
研究及發展支出		(494,377)	(514,083)	(498,365)
其他收益及虧損		(25,272)	43,450	117,847
重組費用		(40,444)	-	-
其他支出		(16,659)	(7,740)	(17,227)
財務費用		(28,617)	(27,629)	(31,309)
合營公司業績持份		7,191	11,494	34,161
除稅前盈利		31,047	434,672	822,411
所得稅開支		(18,294)	(126,731)	(205,586)
本期間盈利		12,753	307,941	616,825
以下各方本期間應佔盈利(虧損):				
本公司持有人		14,626	307,489	616,662
非控股權益		(1,873)	452	163
		12,753	307,941	616,825
每股盈利	3			
- 基本		港幣 0.04 元	港幣 0.75 元	港幣 1.50 元
- 攤薄		港幣 0.04 元	港幣 0.74 元	港幣 1.49 元

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	12,753	307,941	616,825
其他全面(支出)收益			
<i>不會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 其他全面收益以公平價值列賬的權益性工具投資之公平價值(減值)收益淨額	(319)	2,275	-
<i>其後可能會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 換算海外營運公司匯兌差額			
- 附屬公司	(167,044)	(254,083)	(570,039)
- 合營公司	1,441	(23,981)	(21,762)
- 被指定對沖現金流的對沖工具之公平價值(減值)收益	(12,092)	851	28,889
	(177,695)	(277,213)	(562,912)
本期間其他全面支出	(178,014)	(274,938)	(562,912)
本期間全面(支出)收益總額	(165,261)	33,003	53,913
以下各方本期間應佔全面(支出)收益總額:			
本公司持有人	(164,130)	40,777	63,064
非控股權益	(1,131)	(7,774)	(9,151)
	(165,261)	33,003	53,913

## 附註：

### 1. 主要會計政策

本財務概要乃按歷史成本基準編製，唯衍生金融工具、其他投資、其他融資資產及於各報告期期末按公平價值計量之若干金融負債除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

### 2. 分部資料

本集團有兩個（二零二二年：兩個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二二年：兩個）主要產品系列。

本集團以可報告之經營分部分析銷售收入和業績如下：

	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
<b>對外客戶分部銷售收入</b>			
半導體解決方案	1,574,647	1,655,186	2,207,835
表面貼裝技術解決方案	1,899,789	2,245,680	2,354,121
	<b>3,474,436</b>	<b>3,900,866</b>	<b>4,561,956</b>
<b>分部盈利</b>			
半導體解決方案	(110,592)	27,499	297,000
表面貼裝技術解決方案	258,028	428,151	460,885
	<b>147,436</b>	<b>455,650</b>	<b>757,885</b>
利息收入	19,876	15,220	7,330
財務費用	(28,617)	(27,629)	(31,309)
未分配其他收入及其他收益	13,792	5,514	6,073
未分配外幣淨匯兌(減值)收益及外幣 遠期合約的公平價值變動	(34,123)	40,760	117,771
未分配一般及行政費用	(37,405)	(58,597)	(52,273)
合營公司業績持份	7,191	11,494	34,161
重組費用	(40,444)	-	-
其他支出	(16,659)	(7,740)	(17,227)
除稅前盈利	<b>31,047</b>	<b>434,672</b>	<b>822,411</b>
<b>分部盈利之百分比</b>			
半導體解決方案	-7.0%	1.7%	13.5%
表面貼裝技術解決方案	13.6%	19.1%	19.6%

### 3. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 六月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二二年 九月三十日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利 (本公司持有人應佔之 本期間盈利)	<b>14,626</b>	307,489	616,662
	截至 二零二三年 九月三十日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二三年 六月三十日 止三個月 股份數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二二年 九月三十日 止三個月 (未經審核)
計算每股基本盈利之普通股加權 平均股數	<b>412,143</b>	412,290	411,501
潛在攤薄影響之股數：			
- 僱員股份獎勵計劃	<b>1,711</b>	762	2,180
計算每股攤薄盈利之普通股加權 平均股數	<b>413,854</b>	413,052	413,681

## 香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬

於二零二三年第三季度的財務表現，集團已提供經調整盈利及經調整每股盈利，作為集團根據香港財務報告準則（「HKFRS」）呈列的綜合業績之補充。集團相信，上述額外數據能為股東及投資者提供有關集團持續經營表現的有用補充資料，有助分析及比較各期間的財務趨勢及業績。經調整盈利及經調整每股盈利不包括重組費用的影響，重組費用主要與僱員遣散費用及福利安排有關。

採用該等非香港財務報告準則計量作為分析及比較工具存在一定的局限性。故建議股東及投資者不應將其與集團根據香港財務報告準則所呈報的財務業績分開考慮或視作替代分析。此外，該等非香港財務報告準則計量的定義可能有別於其他公司使用的類似詞彙。

下表載列集團根據香港財務報告準則編製的二零二三年第三季度財務計量與非香港財務報告準則計量的對賬。

	截至二零二三年九月三十日止三個月			
	賬列 港幣千元 (未經審核)	非香港財務報告準則調整		經調整 港幣千元 (未經審核)
重組費用 港幣千元 (未經審核)		所得稅之影響 港幣千元 (未經審核)		
本期間盈利	12,753	40,444	(7,785)	45,412
盈利率	0.4%			1.3%
本公司持有人應佔盈利	14,626	40,444	(7,785)	47,285
每股基本盈利(港幣元)	0.04			0.11

附注：集團於二零二三年第二季度及二零二二年第三季度皆無相應的非香港財務報告準則計量調整。

## 財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二三年九月三十日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

## 董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及Guenter Walter Lauber 先生。

承董事會命  
董事  
黃梓達

香港，二零二三年十月二十四日